

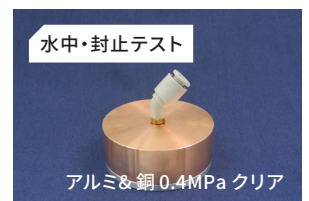
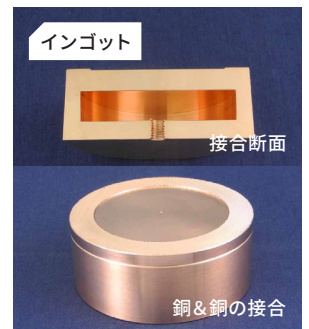
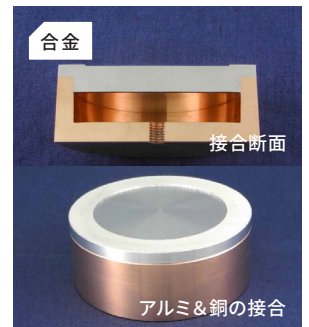


# Bonding ボンディング

Patented

## 各種金属のインゴット合金三次元接合

ハーメチック封止接合



### Product used 使用する装置

15MZs [VVBホーン]



AP-J-0046A4-2025040101